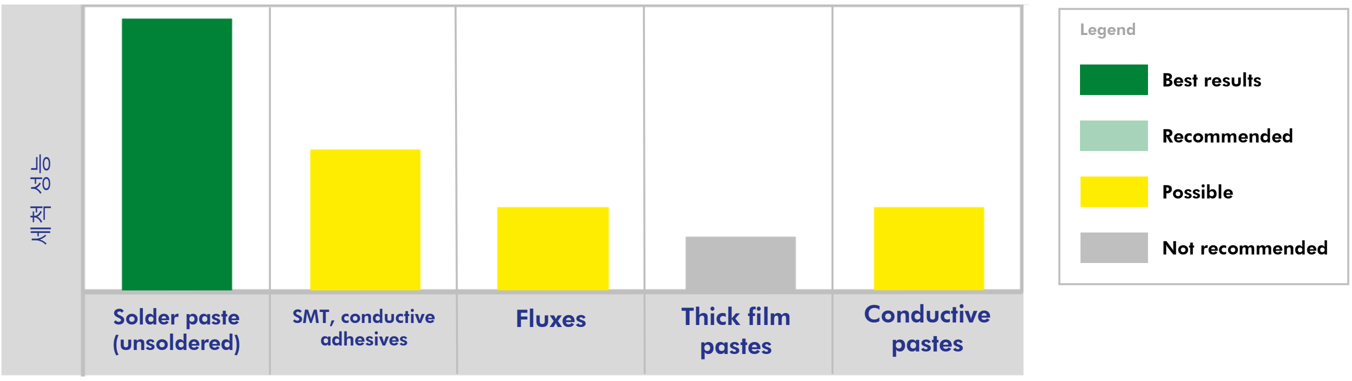
VIGON® SC 200

솔더 페이스트와 SMT 접착제 제거를 위한 수계 기반 세척제

VIGON® SC 200 은 SMT 스텐실을 상온에서 세척할 수 있도록 개발된 수계기반 세척제입니다. MPC® 기술에 기반하여 솔더 페이스트와 SMT 접착제들을 한번에 완벽히 제거하며, 프린터의 스텐실 밑면 세척에도 사용 가능합니다. 스프레이 타입과 초음파 세척 시스템을 위해 개발되었으며, 미스프린팅 된 솔더 페이스트 세척에도 권장됩니다. 또한, 플럭스 타입에 따라 한쪽이 이미 인쇄된 Double-sided PCBA 의 미스프린팅에도 적용될 수 있습니다.

적용 범위 – 스텐실 및 미스프린팅 클리닝



다른 세척제와 비교 시 이점

- 높은 bath 로딩 능력과 뛰어난 여과성으로 bath 수명이 길어 유지 비용이 낮습니다.
- 가벼운 제형으로, 스텐실과 물질 호환성이 뛰어납니다.
- Spray-in-air 시스템 및 초음파 딥탱크, 프린터에도 적용 가능합니다.
- 실온에서 세척하는 것을 권장 드립니다.
- 인화점이 없어서 방폭 장치가 필요 없는 수계용액입니다.
- 클로즈 루프 시스템에서 사용됩니다.
- Spray-in-air 시스템에서 거품이 생기지 않으며, 린스 부분에 유기물이 남지 않는 low odor 용액입니다.
- VIGON® SC 200은 스텐실 프린터 사용을 위해 국제적인 제조업체의 승인을 받았습니다. 승인 서명은 ZESTRON 에서 받으실 수 있습니다.

공정 단계

세척 공정	1. 세척	2. 린스	3. 건조
스프레이 타입 장비	VIGON® SC 200	VIGON® SC 200, water or DI-water[1]	Hot air or circulating air
초음파 장비	VIGON® SC 200	VIGON® SC 200, water or DI-water[1]	Hot air or circulating air
SMT 프린터	VIGON® SC 200	not applicable	vacuum drying

[1] 물의 경도에 따라 일반 물도 스텐실 세척에 충분할 수 있습니다. 하지만 물의 경도가 높으면 석회 자국이 남을 수 있습니다. 미스프린트 세척의 경우, DI-water 로 린스하는 것이 바람직합니다.